



반도체 테스트 부문
Total Solution Provider

ANNOUNCEMENT OF 3Q23 PERFORMANCE



Disclaimer

본 자료는 기관투자자들을 대상으로 실시되는 presentation에서 정보 제공을 목적으로 주식회사 티에프이 (이하 "회사")에 의해 작성됐으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다. 본 presentation의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 받아들이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 대한 위반에 해당될 수 있습니다.

본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 미래 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)'등과 같은 단어를 포함합니다. 위 "예측정보"는 경영 환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며 실제 미래 실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

미래 전망은 presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 시장 환경과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 시장 환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대해 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 하지 않으며, 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

반도체 테스트 부문
Total Solution Provider



Table of Contents

Prologue

Chapter 01 Business Performance

Chapter 02 Market Insight

Chapter 03 Growth Strategy

Appendix




반도체 테스트 부문의 Total Solution Provider

회사 개요

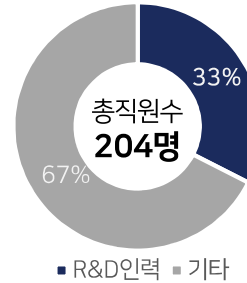
회사명	주식회사 티에프이
대표이사	문 성 주
설립일	2003년 10월 29일
자본금	11.38 억 원
임직원수	204명 (R&D 67명)
본사주소	경기도 화성시 반월길 50-8
사업분야	반도체 테스트 핵심 부품 개발 제조 및 판매
홈페이지	www.tfe.co.kr

R&D 인력 비중 및 연구개발 투자 현황



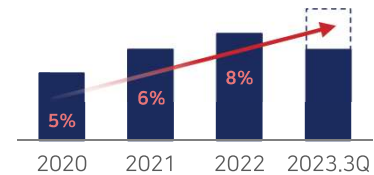
2023년 1월
제3기업부설연구소 설립

[연구인력 비중]



[연도별 연구개발비]

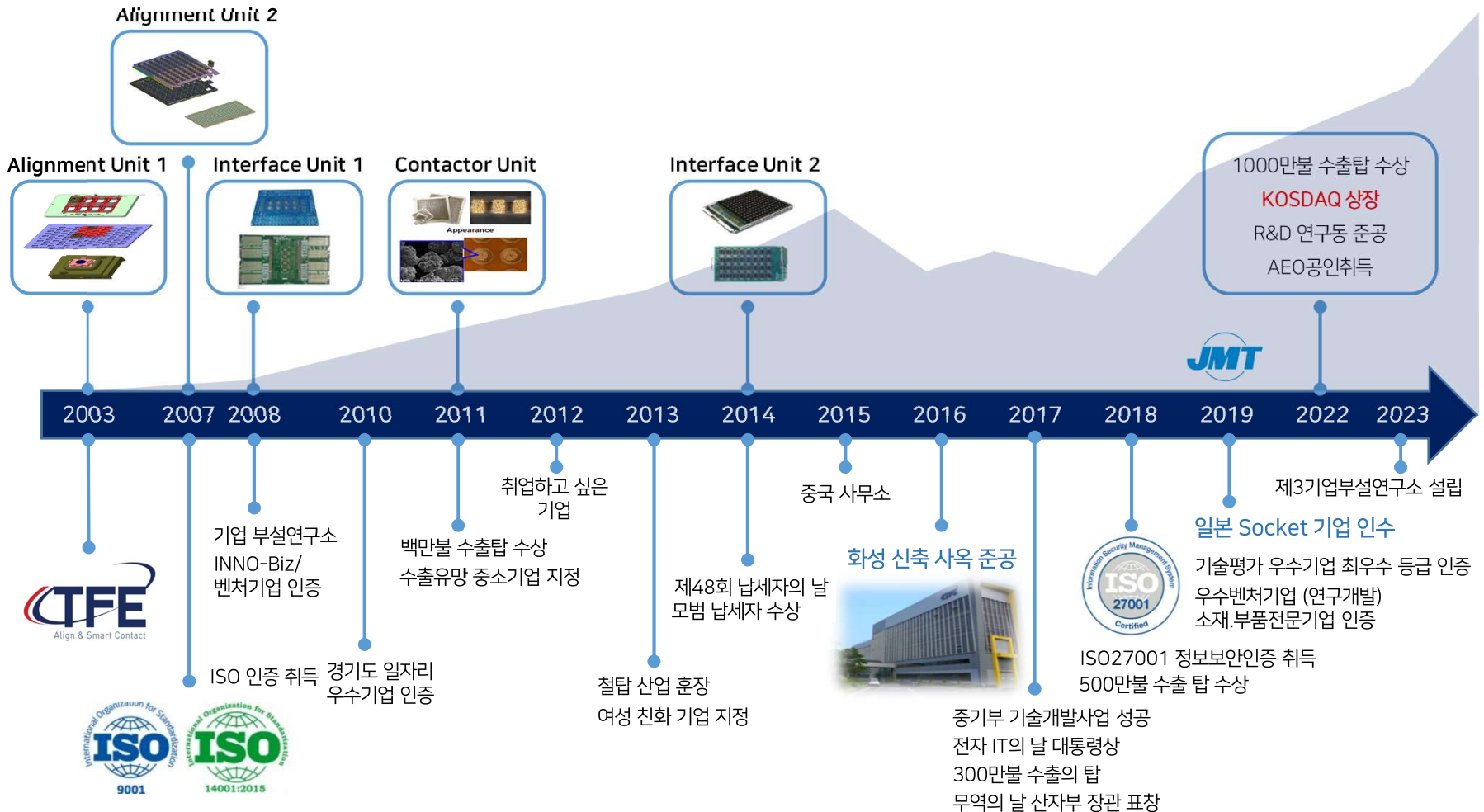
(단위: 백만 원)



특허 및 지적 재산권 현황

테스트 소켓 25건 등록 13건 출원 12건	보드 20건 등록 19건 출원 1건	COK 54건 등록 43건 출원 7건
---	--	---

TFE는 Solution 다양화를 통해 반도체 검사 공정 분야에서 세계 최고를 지향하고 있습니다.



글로벌 기업으로의 성장을 위한 Infra 구축

Infra 현황

- Manufacturing
- Sales Office
- Agency



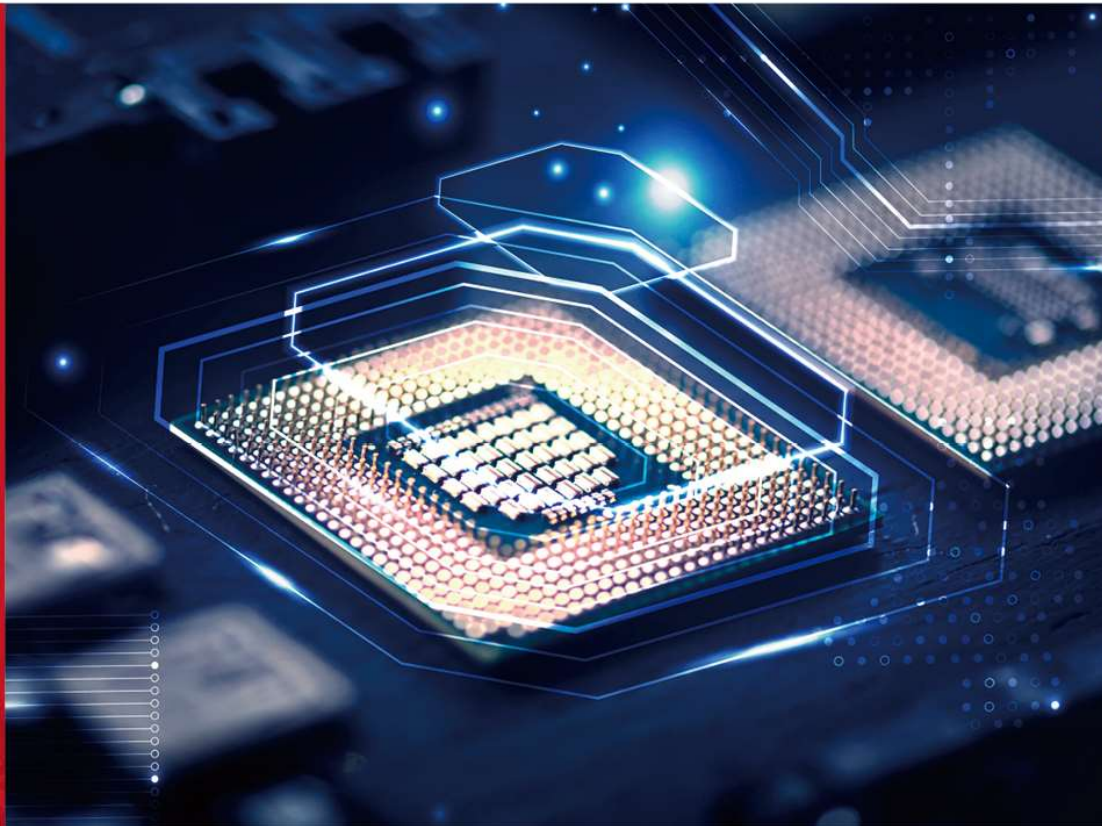
- 01 미국 내 지사 설립 준비 중**

 - ✓ 현지 직원 채용 완료
 - ✓ 다수 글로벌 고객사의 본사 소재국인 미국 시장에 대한 적극적인 공략
- 02 해외 거점 Partnership의 체결**

 - ✓ 미국, 대만, 이스라엘, 싱가포르
 - ✓ 지속적인 Agency 모색
- 03 활발한 국내·외 전시회 참가**

 - ✓ TestConX(미국), Semi SEA(말레이시아), SWTEST(미국)
 - ✓ 23년 하반기 5개 전시회 참가 예정

Semiconductor Test
Total Solution Provider



01

Business Performance

- 3Q, 2023

고성능 Test Solution 제공을 통한 지속적인 매출 확대 달성

2023 3Q (누적)

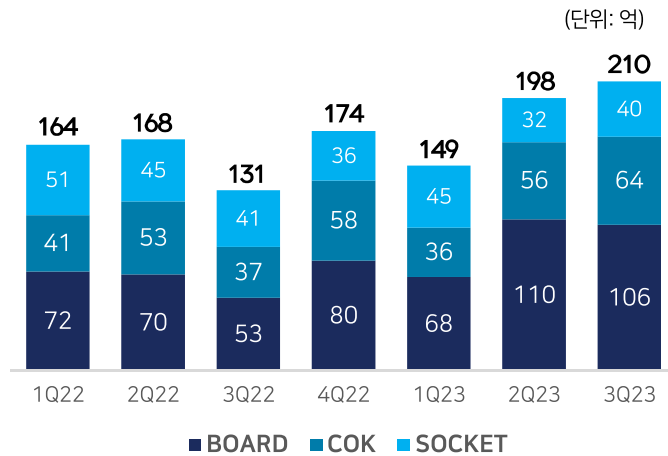
557

억

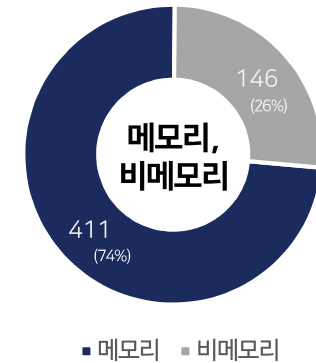
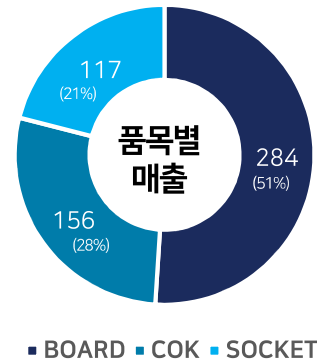
YoY 60% ↑, QoQ 6% ↑

※ 연결재무제표 기준

분기별 매출 현황



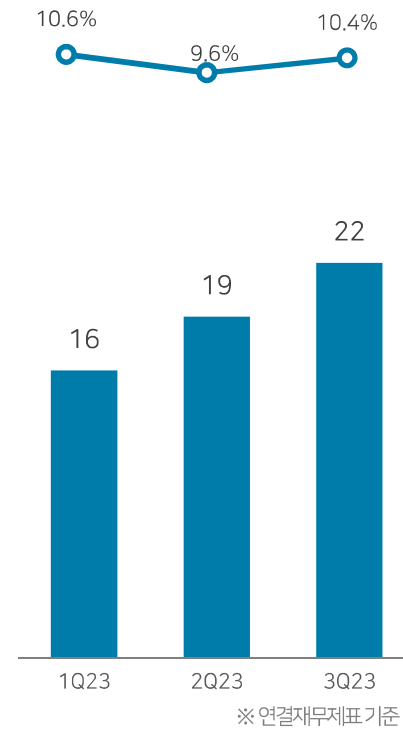
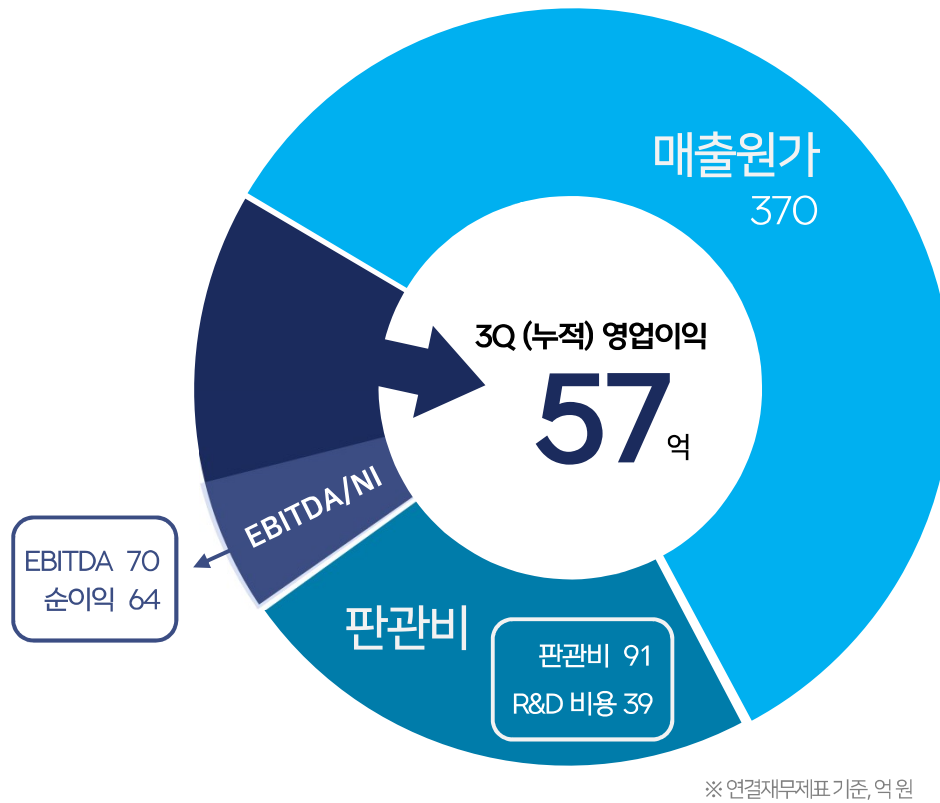
품목별 매출 현황



지속적인 R&D 투자 강화 및 견조한 영업이익 유지

■ 분기별 영업이익 현황

(단위: 억 원, %)



재무건전성을 통한 사업 확장, 차세대 반도체산업 투자

(단위: 억)



주요 재무비율

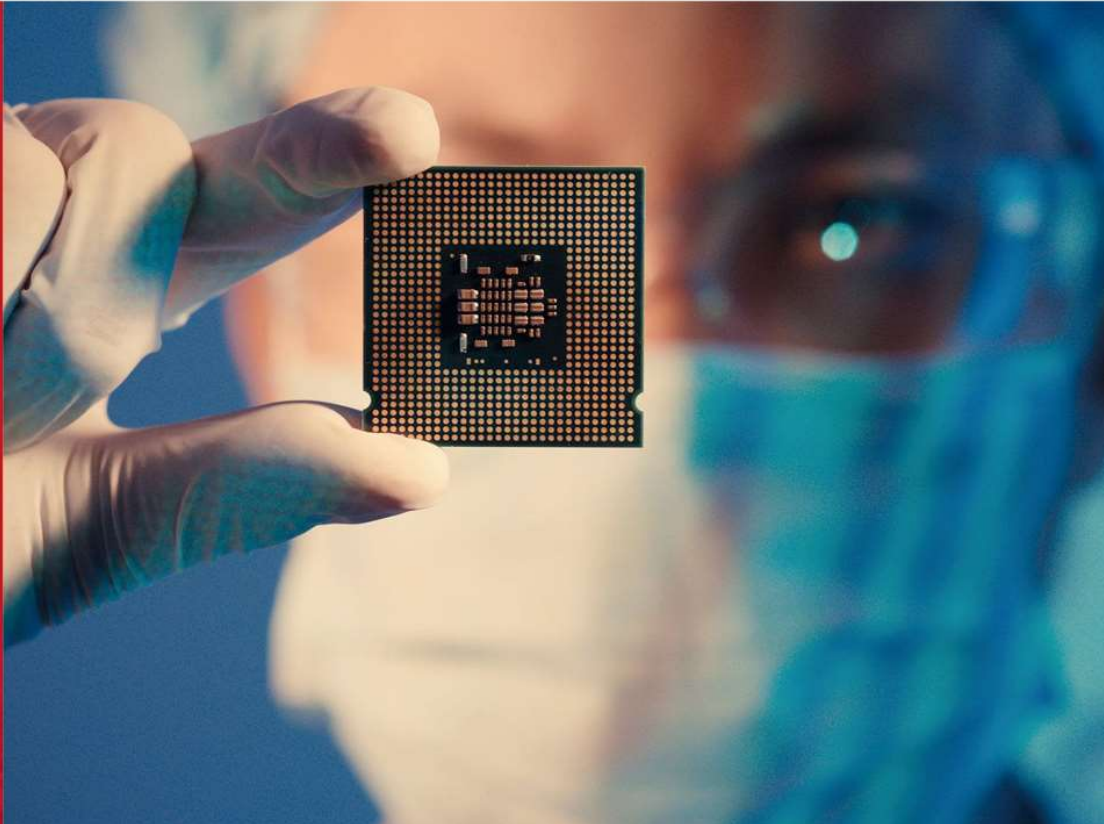
유동비율	부채비율	차입금 비율
313.43%	35.63%	10.45%

“ 건전한 재무구조 유지
제2의 도약을 위한 초석 ”

※ 연결재무제표 기준

02

Market Insight



Semiconductor Test
Total Solution Provider

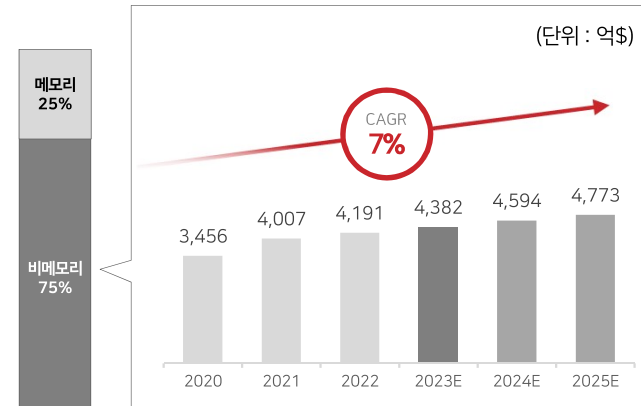
전방 수요처별 반도체 매출 전망



	'20	'21	'22	'23E	'24E	'25E	'26E	'27E
PC	124	155	140	115	136	156	162	164
데이터센터	53	65	61	50	71	90	86	86
자동차	37	51	62	71	84	98	107	114
모바일	118	147	139	109	133	143	139	137
인프라	36	45	53	49	53	59	65	64
소비가전	50	66	67	59	67	73	73	77
산업	51	65	74	74	84	93	101	109
계	469	594	596	527	628	712	1,320	751

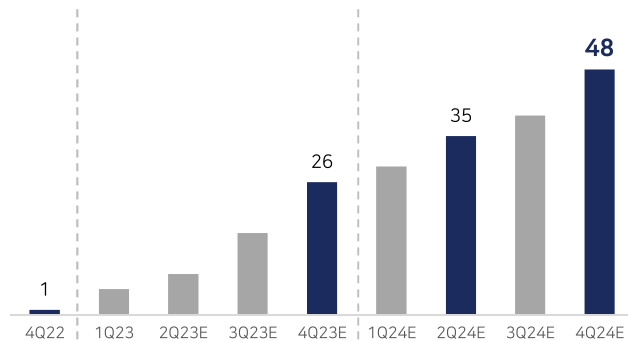
※ 출처 : 국제금융센터 '글로벌 반도체 업황 전망 및 국내 영향(2023.05.18)' 자료 재인용

비메모리 반도체 시장 전망



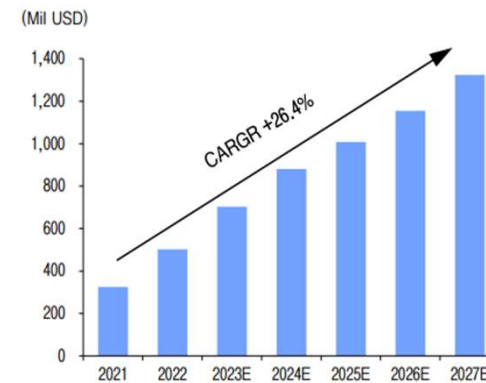
※ 출처 : Omdia

DDR5 시장 침투율



※ 출처 : Omdia, 신한투자증권 추정

세계 연간 HBM 시장 전망



※ 출처 : Development, 이베스트투자증권 리서치센터

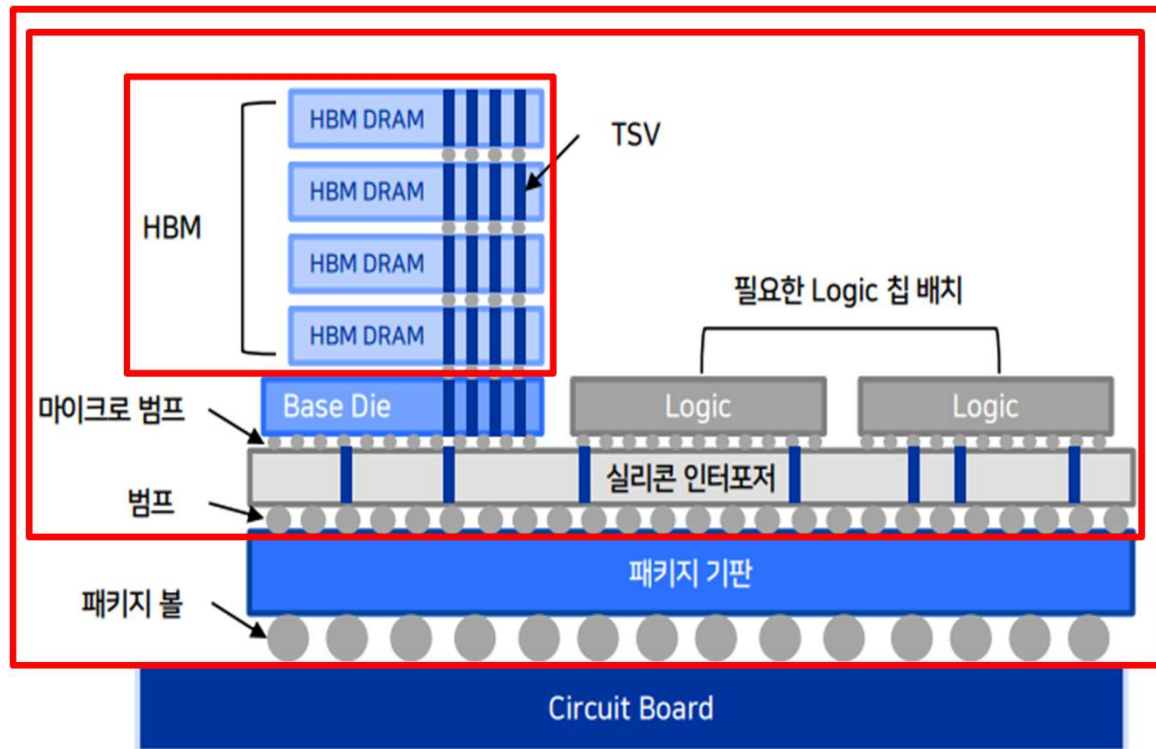
Semiconductor Test
Total Solution Provider



03

Growth Strategy

CoWoS(Chip On Wafer on Substrate)



3-Step Test
Total Solution 제공
(소켓, 보드, COK)

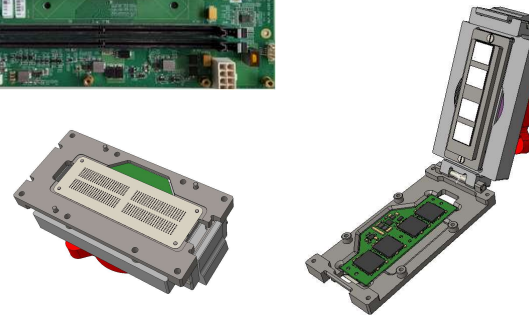
※ 출처 : SemiAnalysis, 이베스트투자증권 리서치센터

■ New Chips, Advanced Packaging 중요도 증가 - New Opportunities

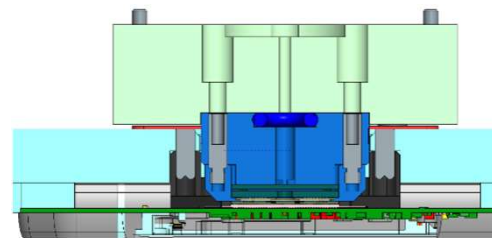
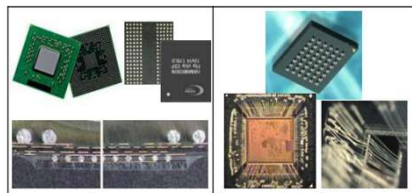
차세대 CPU Module Test Solution



차세대 LPCAMM Socket Test solution

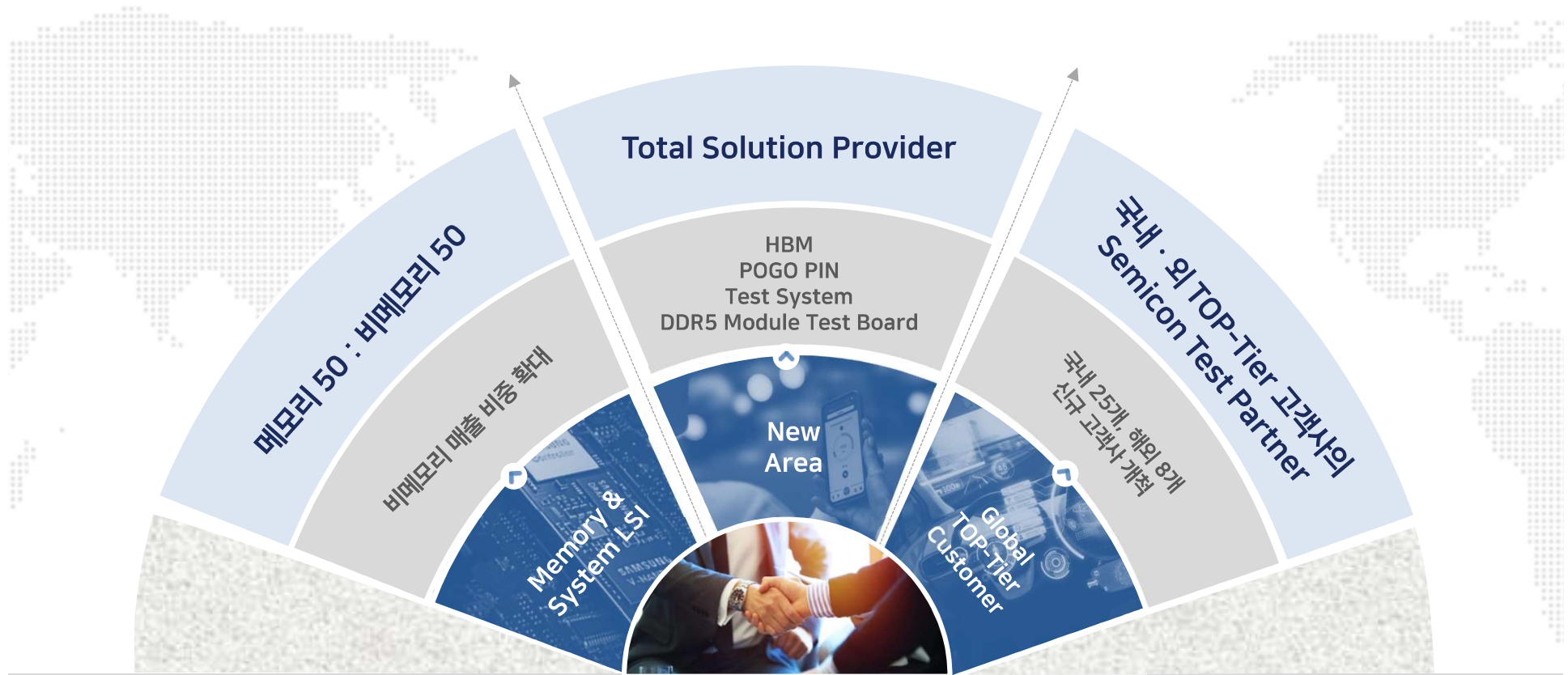


차세대 Mobile향 Test Total Solution 제공



Memory BIB - Maximized Density 개발, 생산성 향상 solution 제공

“Global NO.1” Semiconductor Total Solution Provider



Semiconductor Test
Total Solution Provider



Appendix

01. 요약 재무제표

01 요약 재무제표

요약 재무상태표

(단위: 백만원)

구 분	2023.3Q	2022	2021
유동자산	54,904	54,503	32,810
비유동자산	35,096	28,372	22,239
자산총계	90,000	82,875	55,049
유동부채	17,517	16,068	16,697
비유동부채	6,125	6,225	8,469
부채총계	23,642	22,293	25,166
자본금	1,138	1,138	900
자본잉여금	23,991	23,991	-
기타자본항목	(917)	(326)	(73)
이익잉여금	42,146	35,779	29,057
자본총계	66,358	60,582	29,884

※ 연결 재무제표 기준

요약 손익계산서

(단위: 백만원)

구 분	2023.3Q(누적)	2022	2021
매출액	55,656	63,747	71,963
매출원가	37,046	42,661	49,381
매출총이익	18,610	21,086	22,582
판매관리비	12,954	14,573	11,687
영업손익	5,656	6,514	10,895
영업외수익	2,300	1,185	1,449
영업외비용	637	921	394
법인세 차감전순이익	7,319	6,778	11,950
법인세비용	951	56	2,103
당기순이익	6,368	6,722	9,847